

주석도금

코텍은 다양한 표면처리기술을 전문적으로 보유하고 있으며 다양한 표면처리품목 생산을 위한 개발과 품질관리에 힘쓰고 있습니다.



생산 품목 및 적용

분야/소재		방산, 원자력, 전기, 전자, 반도체 장비 / Fe, STS, Al, Cu	
용도		납땜, 부식성, 질화중경화층 형성방지, 응착방지	
두께 (일반기준)		1~20 μ m 이상	
적용기준	국방0115-0019(연) MIL-T-10727 ASTM B 545 FEIS 104 KSD 8330	두께	납땜용 : 2.5 μ m~6.4 μ m 응착방지용 : 5.0 μ m~10 μ m 부식방지용 : 7.5 μ m 질화중 경화방지 : 5 μ m~15 μ m
		밀착성	180° Bending 후 도금층 분리흔적 없을 것
		내식성 시험	20% Nacl 24hr 염수시험 (2.5cm ² 에 Pit 6개 미만일 것)
승인현황		국외기업	
		국내기업	두원중공업, 한화디펜스, 한화탈레스, LIG넥스원, KAI, 국방과학연구소

설비현황

(주)코텍	1,500 × 600 × 1,200 mm
-------	------------------------

주석도금

복잡한 형상 부분 작업 가능

보유기술별 특성 및 적용제품

특성

- 주석은 연성과 전성이 크고 용점이 231.9°C로 낮다.
- 은회색의 금속으로 열전도는 은의 1/3이고, 전기 전도도는 1/7이다.
- 주석은 인체에 해가 적어 식기나 식기의 도금에 사용하고, 유기산에 강해 통조림의 내부 도금에 사용한다.
- 납땀성이 우수하고 전기, 전자부품의 도금에 많이 활용한다.
- 철 소재상의 주석도금은 아연도금과 달리, 도금에 핀홀이 있으면 철 소재가 양극이 되어 부식이 빠르게 진행된다.
- 구동부나 피스톤 등에 주석치환도금이나 전기주석도금을 하여 윤활성, 구동성을 향상시킨다.

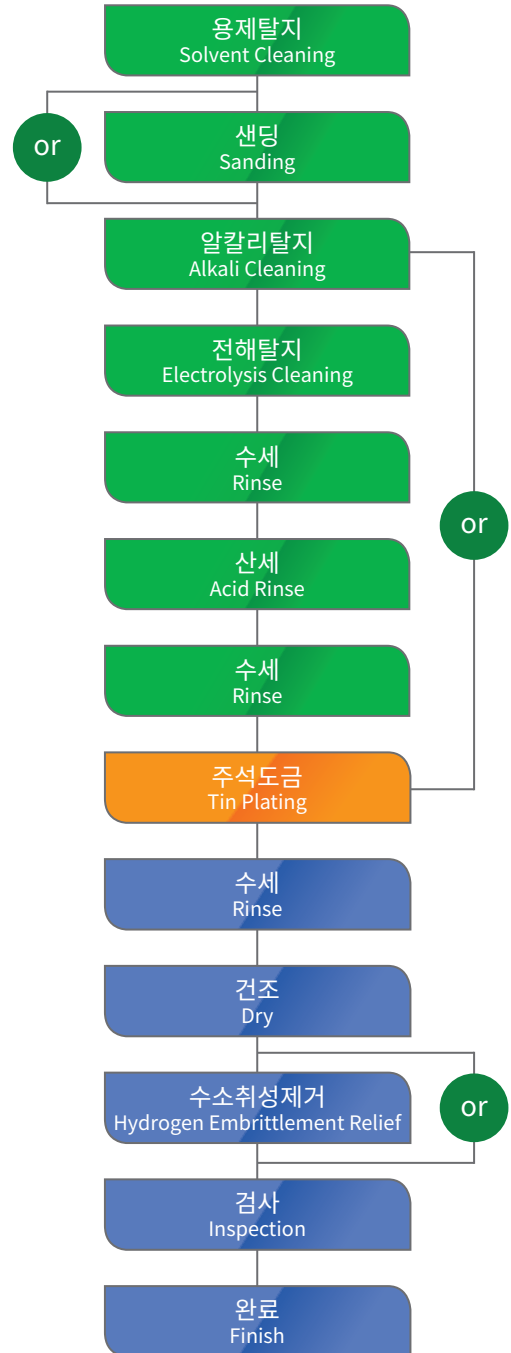
적용제품

- 방산부품, 항공부품, 자동차부품, 건축용 세시

코텍 도금 공정



공정도



위 도금공정은 주식회사 코텍의 콘텐츠이므로 무단복제 및 도용을 금합니다. 본 콘텐츠를 사용하시려면 별도로 문의를 바랍니다.